

半導体・電子材料精製用イオン交換樹脂 ORLITE™ DS/DRY シリーズ

「ORLITE™ (オルライト)」はオルガノ社が超純水製造で培ったイオン交換技術を活用して開発した、半導体・電子材料精製用イオン交換樹脂です。

半導体材料・電子材料に求められる高純度化

機器の高性能化に伴い、半導体および電子材料において、更なる高純度化が要求されています。ORLITE™ は金属をpptレベルまで低減させることができる超低メタル化樹脂「DSシリーズ」と、非水溶系の精製を可能とした乾燥樹脂「DRYシリーズ」をラインアップしています。



【超低メタル化】イオン交換樹脂 ORLITE™ DS シリーズ	【乾燥】イオン交換樹脂 ORLITE™ DRY シリーズ
<ul style="list-style-type: none"> 薬液を高度精製するために、 <ul style="list-style-type: none"> 樹脂からの溶出金属を低減 樹脂からの溶出金属量を保証 超低メタル化 陽イオン、陰イオン、キレート樹脂を ラインアップ 	<ul style="list-style-type: none"> 水分の持ち込みが少ない 水分低減の前処理が不要、 または短縮できる 陽イオン、陰イオン、混床樹脂をラインアップ

精製対象(例)

ORLITE™ シリーズは液状(または精製時に液状にできる)の半導体材料の精製に採用されています。下記のような半導体材料の最終製品だけでなく、その原材料の精製にも使われています。

前工程	<ul style="list-style-type: none"> シリコンウエハ フォトマスク ・ フォトレジスト ・ レジスト現像液 アンモニアガス シランガス 	<ul style="list-style-type: none"> Low-k材料 High-k材料 メタルプリカーサ 六フッ化タングステン プロピレン/ アセチレンガス PFCエッチングガス 	<ul style="list-style-type: none"> HFCエッチングガス 硫化カルボニル 塩素系ガス 臭化水素 三フッ化窒素 フッ素混合ガス 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 高純度洗浄液 イソプロピルアルコール CMP後洗浄液/ スラリー/パッド ターゲット材 バッファークコート膜、 再配線形成材料
後工程	<ul style="list-style-type: none"> バックグラインドテープ ダイシングテープ 	<ul style="list-style-type: none"> パッケージ基板用 銅張積層板材料 	<ul style="list-style-type: none"> 封止材 	

※ **赤字** 記載部分はより効果を発揮しやすい対象材料

検討から実機化まで ~ご相談・ご提案も承ります~

検討段階から実機化まで、オルガノ社によるサポートが可能です。

① 材の選定、 実験条件の設定



材の選定・実験条件のご提案、
結果に対するコメント

② 実験、 試験、 評価



③ スケールアップ、 パイロット化、 実機化

スケールアップに必要な機器の
貸し出し・販売、実機化・効率的な
運転方法のご提案



Units 9-12 and 15-18, Level 28, Tower 1, The Millenium, 98 How
Ming Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
TEL: +852-2799-9019 FAX: +852-2799-9808